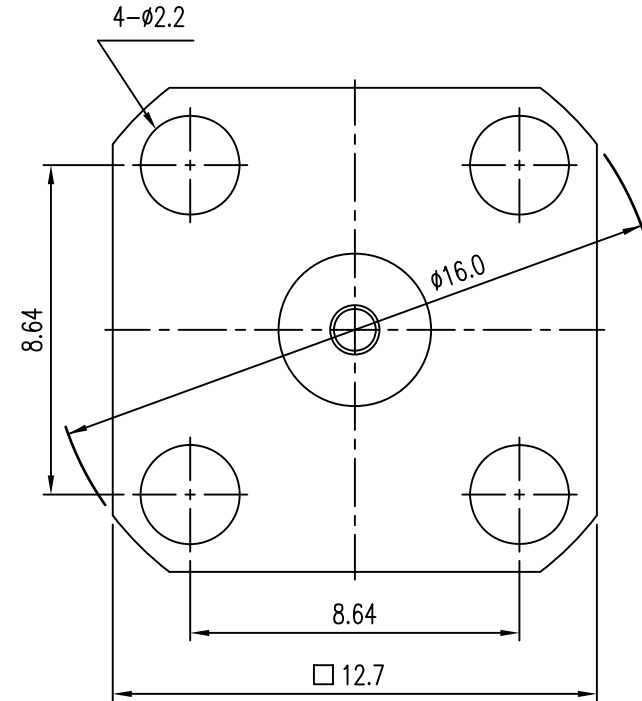
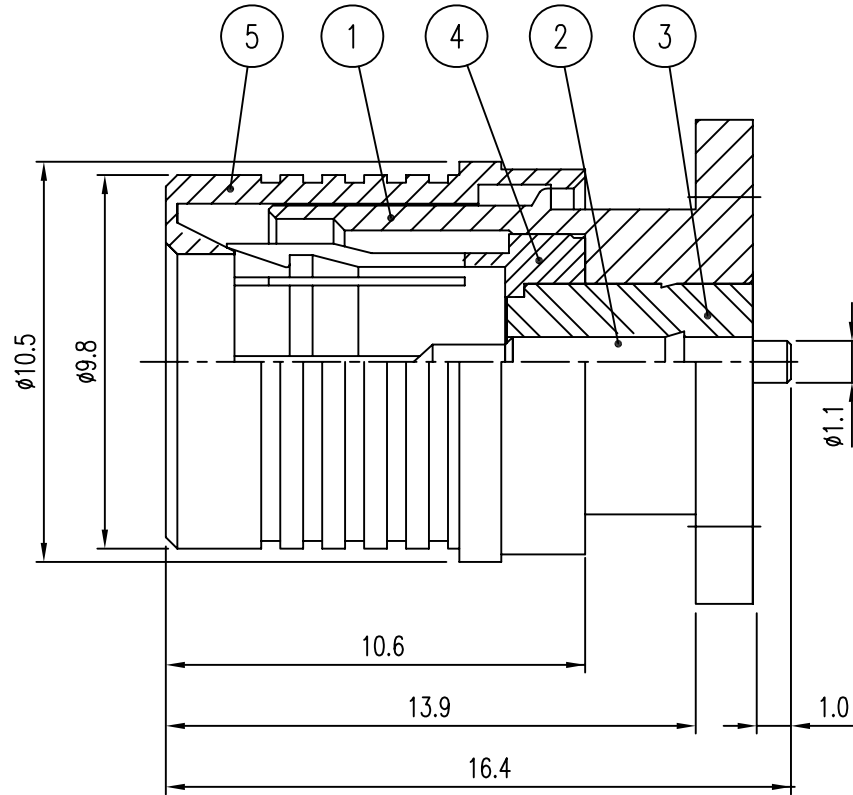


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	(첨변No.201504-0006) BODY 표준화 치수 변경 및 TEFLON, JACK, CAP 코드 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.	04.	15.			
2	(첨변No.201806-0002) QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.	06.	11.			



5	CAP	1	MBsBD	SUCO Plate	DCU02169-5/1
4	JACK	1	BeCu	SUCO Plate	DJA00209-5/4 DJA00200-5/2
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02585-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	SUCO Plate	DCT00946-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate	DBD01213-5/2

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차		년월일		2018. 06. 11.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
소수 각도 분수		승인	I.C.KIM		검도			
재질		제도	S.Y.EUN		도명			KQMA50 SOLDER END PS-4H
열처리		작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00853-7/4	
보호파막처리		적도	5/1	단위	mm			중량

* 조립주의 *

- CAP 조립시 JACK이 눌리지 않도록 HAND PRESS 및 AIR PRESS 등
조절하여 작업 할 것 (조립 가능한 최소거리 설정)